杭州立昂微电子股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

（上接A45版）

三、关于招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺

（一）公司承诺

若本公司本次公开发行股票的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格应按发行价格加上股票发行日至回购日银行同期存款利率计算的利息或相关监管部门认可的其他价格确定（如公司股票因派发现金红利、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，新股数量亦相应进行除权调整），并根据相关法律法规规定的程序实施。上述回购实施时法律法规另有规定的从其规定。本公司将及时提出预案，并提交董事会、股东大会讨论。

若因本公司本次公开发行股票的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。

（二）控股股东、实际控制人承诺

若本公司本次公开发行股票的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将极力促使发行人回购首次公开发行的全部新股，并依法回购已转让的原限售股份。

若发行人本次公开发行股票的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。

（三）全体董事、监事、高级管理人员承诺

若因发行人本次公开发行股票的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

四、本次发行相关中介机构的承诺

（一）保荐机构东方证券承销保荐有限公司承诺

若因东方投行为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。

（二）发行人律师国浩律师（上海）事务所承诺

因国浩在本次发行工作期间未勤勉尽责，导致国浩所制作、出具的文件对重大事件作出违背事实真相的虚假记载、误导性陈述，或在披露信息时发生重大遗漏，导致发行人不符合法律规定的发行条件，造成投资者直接经济损失的，在该等违法事实被认定后，国浩将本着积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，自行并督促发行人及其他过错方一并对投资者直接遭受的、可测算的经济损失，选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式进行赔偿。

（三）发行人会计师中汇会计师事务所（特殊普通合伙）承诺

因中汇为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失，如能证明中汇没有过错的除外。

五、公开发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向

发行人本次公开发行前持股5%以上股东王敏文、宁波利时、泓祥投资承诺：在股份锁定期期满后，本人/本公司/本企业每年减持发行人股份的总数不超过本人/本公司/本企业持有的发行人股份总数。其中，本人/本公司/本企业每年通过集中竞价交易和大宗交易的方式减持发行人股份的总数将遵照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规章及其他规范性文件的规定执行，即：采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；采取大宗交易方式减持的，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。本人/本公司/本企业拟减持发行人股票的，将提前三个交易日通知发行人并予以公告。若届时相关规定发生变化的，遵照新规定执行。

六、关于未能履行承诺的约束措施

公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员如若不能履行招股意向书中列明的承诺，则采取或接受以下措施：

承诺主体	违反承诺的约束措施
发行人	1、如本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外），本公司将采取以下措施：（1）及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向本公司投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；（3）将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议；（4）本公司违反承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿。 2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本公司将采取以下措施：（1）及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向本公司的投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护本公司投资者的权益。
控股股东、实际控制人	1、如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），本人将采取以下措施：（1）通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护立昂微电及其投资者的权益；（3）将上述补充承诺或替代承诺提交立昂微电股东大会审议；（4）本人违反承诺所得收益将归属于立昂微电，因此给立昂微电或投资者造成损失的，将依法对立昂微电或投资者进行赔偿。 2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：（1）通过立昂微电及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向立昂微电及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护立昂微电及其投资者的权益。
董事、监事、高级管理人员	1、如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），本人将采取以下措施：（1）通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护立昂微电及其投资者的权益；（3）将上述补充承诺或替代承诺提交立昂微电股东大会审议；（4）本人违反承诺所得收益将归属于立昂微电，因此给立昂微电或投资者造成损失的，将依法对立昂微电或投资者进行赔偿。 2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：（1）通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护立昂微电及其投资者的权益。

七、填补被摊薄即期回报的措施及承诺

（一）发行人关于填补被摊薄即期回报的措施

本次公开发行完成后，公司每股收益和净资产收益率等指标在短期内可能出现一定幅度的下降。为降低本次公开发行摊薄即期回报的影响，充分保护中小股东的利益，公司制定了如下措施：

1、加强募集资金管理

本次发行的募集资金到账后，公司董事会将开设募集资金专项账户，确保专款专用，严格控制募集资金使用的各环节。

2、完善利润分配制度，强化投资者回报制度

为了明确本次发行后对投资者的回报，《公司章程》明确了有关利润分配政策的决策制度和程序的相关条款；为更好的保障全体股东的合理回报，进一步细化公司章程中有关利润分配政策的相关条款，制定了《公司上市后未来三年分红回报规划》。公司上市后将严格按照章程的规定，完善对利润分配事项的决策机制，重视对投资者的合理回报，积极采取现金分红等方式分配股利，吸引投资者并提升公司投资价值。

3、积极实施募投项目

本次募集资金紧密围绕公司主营业务，符合公司未来发展战略，有利于提高公司持续盈利能力。公司对募集资金投资项目进行了充分论证，在募集资金到位前，以自有、自筹资金先期投入建设，以争取尽早产生收益。

4、积极提升公司竞争力和盈利水平

公司将致力于进一步巩固和提升公司核心竞争优势、拓宽市场，努力实现收入水平与盈利能力的双重提升。

5、关于后续事项的承诺

公司承诺将根据中国证监会、上海证券交易所后续出台的实施细则，持续完善填补被摊薄即期回报的各项措施。

（二）发行人控股股东、实际控制人、董事、高管关于公司填补被摊薄即期回报措施的承诺

公司控股股东、实际控制人王敏文对公司填补回报措施能够切实履行作出如下承诺：

“本人不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。”

公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够切实履行作出如下承诺：

“1、本人承诺将不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2、本人将严格自律并积极使公司采取实际有效措施，对公司董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；

3、本人将不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

4、本人将积极促使由公司董事会或薪酬委员会制定、修改的薪酬制度与公司首发填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、本人将积极促使公司未来拟制定的股权激励的行权条件与公司首发填补回报措施的执行情况相挂钩；

6、本人将根据中国证监会、证券交易所等监管机构未来出台的相关规定，积极采取一切必要、合理措施，使公司首发填补回报措施能够得到有效的实施；

7、如本人未能履行上述承诺，本人将积极采取措施，使上述承诺能够重新得到履行并使公司首发填补回报措施能够得到有效的实施，并在中国证监会指定网站上公开说明未能履行上述承诺的具体原因，并向公司股东道歉。”

八、发行前滚存未分配利润的分配

根据2018年1月12日公司2018年第一次临时股东大会通过的决议，公司本次发行前滚存的未分配利润由上市后的新老股东按持股比例共享。

九、公司发行上市后股利分配政策

公司于2017年4月18日召开了2017年第二次临时股东大会，审议通过了上市后适用《公司章程（草案）》；本次发行上市后，公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润，优先采用现金分红的利润分配方式。在公司实现盈利、不存在未弥补亏损、有足够现金实施现金分红且不影响公司正常经营的情况下，公司将采用现金分红进行利润分配。公司每年以现金分红形式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

十、老股转让的具体方案

本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份（老股转让）。

十一、本公司特别提醒投资者注意风险因素中的下列风险

（一）技术风险

半导体硅片属于半导体的支撑材料行业，其核心工艺包括单晶工艺、成型工艺、抛光工艺、外延工艺等，技术专业化程度颇高。从全球范围来看，半导体硅片（4英寸）最早量产于19世纪80年代，行业经过多年的竞争与洗牌，目前日本、德国、台湾等国家或地区的少数几家厂商垄断了全球九成以上的市场份额，且主流产品的尺寸已经达到12英寸。而我国半导体硅片行业起步较晚，目前国内能够实现半导体硅片批量生产的本土企业也仅有十余家，且绝大部分企业能够量产的最大产品尺寸不超过8英寸。同半导体硅片相似，全球半导体分立器件产品的工艺技术发展也十分迅速，高端半导体分立器件产品的技术含量和制造难度已不亚于大规模集成电路，目前主要由少数国际大型半导体企业供应，而国内分立器件制造企业虽然数量众多，但产品主要集中在中低端领域，技术附加值较低。总体而言，全球半导体行业的先进技术仍被少数国外企业垄断，国内企业通过自主研发、引进吸收等方式已经取得了很大进步，但与国外先进企业相比尚存在较大差距。

目前，在半导体硅片方面，公司的工艺技术水平在国内同行中处于领先地位；在分立器件方面，公司的传统优势产品肖特基二极管芯片在业内也具有较强的市场竞争力；同时，在砷化镓微波射频集成电路芯片产品的开发研制方面，公司通过持续的研发投入，也已取得了核心技术方面的突破，但若未来公司在半导体硅片、半导体分立器件、集成电路芯片等方面的技术研发与革新速度不能及时跟上国内企业对国际领先水平的追赶节奏，或不能快速将行业的新技术运用于产品的开发和升级，公司与国际领先技术水平的差距将被会进一步拉大。

（二）行业需求风险

公司处于半导体行业中的半导体硅片行业和半导体分立器件行业，其行业需求与下游终端应用领域行业的景气度密切相关。例如，2009年，受经济危机的影响，半导体硅片行业和半导体分立器件行业下游传统应用领域景气程度下降，行业利润水平明显降低。2014年至今，受益于通信、计算机、汽车产业、消费电子、光伏产业、智能电网、医疗电子等应用领域需求带动，全球半导体硅片行业和半导体分立器件行业的景气度逐年上升，行业整体的利润水平向好。目前，新能源汽车、人工智能、物联网等新兴产业的逐渐崛起作为半导体硅片行业和半导体分立器件行业新的需求增长点，为公司发展提供了巨大的市场空间。但如果未来全球经济出现经济增速放缓、甚至衰退的情况，下游行业的市场需求量可能下降，将导致公司主营业务无法保持持续增长，从而导致公司经营业绩出现波动。

资料来源：SEMI，2020.02；WSTS，2019.02；2019年分立器件行业需求为预测值

（三）市场竞争风险

发行人主营业务为半导体硅片和半导体分立器件芯片的研发、生产和销售，以及半导体分立器件成品的生产和销售，属于半导体行业中的半导体硅片行业和半导体分立器件行业。近年来，随着通信、计算机、汽车产业、消费电子、光伏产业、智能电网、医疗电子等终端应用领域的快速发展以及人工智能、物联网等新兴产业的崛起，极大的提高了集成电路和分立器件产业的景气度，同时也导致竞争的持续加剧。

在半导体硅片方面，全球半导体市场规模的一半以上以及主要增量都源于逻辑电路和存储器，该部分应用领域已主要采用12英寸半导体硅片进行生产。目前全球12英寸半导体硅片主要产能被少数国际半导体硅片供应商垄断，国内硅片生产企业尚不具备大规模的12英寸硅片量产能力。虽然与国内企业相比，公司目前在半导体硅片的生产技术上及市场份额方面拥有较为显著的竞争优势，同时也自主开发了12英寸单晶生长的核心技术，以及硅片倒角、磨片、抛光、外延等关键技术，但是，与本公司一样，如有研半导体、上海新昇等国内半导体硅片生产企业也正在积极推进国产12英寸半导体硅片的研发及产业化工作，因此，若公司未来不能顺利实现大尺寸硅片的产业化，将会延缓或失去参与争夺全球大尺寸半导体硅片市场的竞争机会，甚至可能被国内竞争对手超越。

在半导体分立器件芯片方面，公司目前的产品主要面临国内竞争对手的竞争。伴随着行业景气度的不断提升，下游应用领域对半导体分立器件的性能要求也越来越高，同时众多半导体分立器件芯片及分立器件生产企业也在不断进行技术和产品升级。目前公司的优势产品主要为肖特基二极管芯片，种类较为单一，MOSFET芯片产品作为后期导入的产品尚未形成较强的市场竞争力。如果公司未来不能正确把握行业发展动态和市场需求变化，持续推动技术研发、生产工艺创新以及产品升级，建立并保持核心产品的市场竞争力，将会在激烈的市场竞争中处于不利地位，进而影响公司的经营业绩。

（四）固定资产投资大，产能爬坡期较长的风险

半导体硅片及分立器件芯片行业属于资金与技术“双密集型”的行业。尤其是半导体硅片，企业要形成规模化、商业化的生产，需要进行金额巨大的固定资产投资，譬如一组抛光机设备的价格就可能高达数千万元，而12英寸以上大尺寸硅片生产线的投资规模更是数以十亿计。同时，大规模的资金投入后，半导体硅片、分立器件芯片的生产线从设备工艺调试，到产品下游验证，再到大规模量产，都需要大量的技术人员对生产线各个环节的技术参数、制造工艺等进行不断的调整与严格的把控。基于该行业特点，半导体硅片与分立器件芯片的生产线从投产至达到设计产能，通常需要经历一个相对较长的产能爬坡期。因此，在生产线产能爬坡的前期，大额的长期资产折旧与摊销等固定成本将在一定程度上影响公司的盈利能力。

（五）原材料价格波动风险

公司生产所用主要原材料为多晶硅、石英坩埚、石墨件、包装盒、切磨材料、抛光材料、外延材料、靶材、金属颗粒等，其价格变化对公司利润具有一定影响。报告期各期，原材料成本占公司主营业务成本的比例分别为51.80%、48.26%、48.71%和52.52%，主要原材料价格的变化对公司毛利率水平有较大影响。虽然公司不断通过技术创新和生产流程优化降低生产成本、扩大产能实现规模经济，并且与主要原材料供应商保持良好的业务合作关系，但公司仍存在原材料价格大幅波动给生产经营带来不利影响的风险。

（六）应收账款发生坏账的风险

报告期各期末，公司应收账款净额分别为31,670.29万元、35,589.17万元、41,259.91万元和45,259.54万元，占流动资产的比例分别为26.55%、20.10%、22.97%和24.95%。报告期末，公司99.00%以上的应收账款账龄均在一年以内，应收对象主要为华润上华、扬州虹扬、中芯国际等知名半导体厂商，上述客户资信良好、实力雄厚，与公司有着良好的合作关系。但如果主要客户的经营状况发生重大不利变化，则可能导致应收账款不能按期收回或无法收回而产生坏账损失，对公司的生产经营和业绩产生不利影响。

（七）偿债风险

受公司主营业务产业链长、产品种类繁多、存货较大等因素影响，公司流动比率、速动比率较低。报告期内，公司的流动比率分别为1.68、1.53、1.07和1.06，公司的速动比率分别为1.05、1.15、0.72和0.68。报告期内公司存在一定的偿债风险。未来，为了保持公司的竞争优势，公司仍将在8英寸硅片、12英寸硅片及第二代半导体射频集成电路芯片方面加大资金投入，如果公司不能及时补充因业务规模不断扩大而引致的资金需求，较低的流动比率和速动比率将会带来一定的偿债风险，从而给公司生产经营和业务发展带来不利影响。

（八）税收优惠政策变动的风险

报告期内，发行人系经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合认定的高新技术企业，发行人控股子公司浙江金瑞泓系经宁波市科学技术局、宁波市财政局、宁波市国家税务局、浙江省宁波市地方税务局联合认定的高新技术企业，发行人控股子公司衢州金瑞泓系经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合认定的高新技术企业，目前持有的《高新技术企业证书》编号分别为GR201733002785（有效期至2020年11月）、GR201833100111（有效期至2021年11月）、GR201933003392（有效期至2022年12月）。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，发行人、浙江金瑞泓、衢州金瑞泓可享受高新技术企业的相关优惠政策，减按15%的税率计缴企业所得税。2019年12月31日，国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、海关总署等四部委联合发布公告（2019年第11号），立昂东芯被列入《基础电路线宽小于0.25微米或投资额超过80亿元、线宽小于0.5微米（含）的集成电路生产企业名单》，享受企业所得税自获利年度起（2016年）五免五减半的优惠政策。

报告期内，发行人因高新技术企业所享受的企业所得税优惠减免的所得税总额占净利润总额的比重为-1.66%；浙江金瑞泓因高新技术企业所享受的企业所得税优惠减免的所得税总额占发行人净利润总额的比重为13.24%；衢州金瑞泓由于2019年及2020年1-3月亏损，立昂东芯由于2017年至2020年1-3月亏损，暂未享受到相关政策的所得税优惠政策。发行人及浙江金瑞泓、衢州金瑞泓执行的高新技术企业所得税优惠政策，以及立昂东芯享受的集成电路企业所得税优惠政策在资格有效期内或在相关集成电路生产企业名单内具有连续性及稳定性，但若未来发行人及浙江金瑞泓、衢州金瑞泓在有效期满后不能持续被认定为高新技术企业，立昂东芯不在相关集成电路生产企业名单内，或国家对相关政策进行调整，发行人、浙江金瑞泓、衢州金瑞泓和立昂东芯将无法继续享受所得税优惠，将对公司的经营业绩造成不利影响。

（九）实际控制人持股比例较低的风险

本次发行前，公司控股股东、实际控制人王敏文直接持有公司股权比例为22.12%，通过泓祥投资和泓万投资控制的公司股权比例为9.80%，合计控制公司31.92%股权。本次发行完成后，实际控制人王敏文合计控制公司股权的比例将进一步下降，在一定程度上可能会降低股东大会对于重大事项决策的效率，从而给发行人生产经营和未来发展带来潜在风险。

（十）浙江大学《确认函》中提及的历史上浙大海纳及其参股公司宁波海纳涉及发行人等三家企业相关股权变动存在相关程序瑕疵可能引致的风险

发行人前身立昂有限，发行人控股子公司浙江金瑞泓前身立立电子以及发行人全资子公司立立半导体（已注销）前身宁波海纳三家企业，历史上曾与浙大海纳（现已更名为浙江众合科技股份有限公司）及其参股公司宁波海纳存在股权回购与股权转让的交易行为。

根据浙江大学（浙大海纳当时的实际控制人）于2018年1月10日出具的《浙江大学关于杭州立昂微电子股份有限公司等三家企业历史沿革中有关事项确认的函》（以下简称“《确认函》”），浙江大学确认浙大海纳及其参股公司宁波海纳历史上涉及发行人等3家企业的8次出资及股权变动已实际发生，真实、有效，但是在相关程序上存在瑕疵。《确认函》提及的程序瑕疵情况如下：

1、4次股权出资变动事项未按规定履行资产评估备案程序。2000年12月立立电子增资和2001年9月宁波海纳退出立立电子时，未按《国有资产评估管理办法》（国务院令第91号）和《国有资产评估管理办法实行细则》（国资办发[1992]36号），对立立电子进行资产评估备案；2002年12月浙大海纳退出立昂有限和2003年12月浙大海纳退出宁波海纳时，未按《国有资产评估管理若干问题的规定》（财政部令14号），对立昂有限和宁波海纳进行资产评估备案。

2、4次股权出资变动事项未按公司章程履行决策程序。2000年12月立立电子增资、2002年7月宁波海纳退出立昂有限、2002年3月和7月宁波海纳接受立立电子投资时，宁波海纳和浙大海纳内部的决策程序存在一定瑕疵。

上述股权变动发生以来，相关交易对方从未以相关程序瑕疵为理由向发行人及其子公司提出过给予任何形式的补偿、回转、或否定现状等任何请求。2009年5月10日，海纳科技（浙大海纳更名后）董事会对历史上需要董事会批准的相关股权变动事项进行了追溯确认；2018年1月10日，浙江大学亦对相关股权变动的真实、有效性进行了确认。发行人及其控股子公司浙江金瑞泓的股权结构一直以来清晰、稳定。

尽管如此，发行人仍无法排除相关利益方未来就《确认函》提及的相关程序瑕疵，通过司法途径向发行人寻求利益补偿，给发行人带来经济损失的可能性。

针对上述情况，2020年6月12日，浙江省国资委出具了《请示函》，经对相关股权变动事项进行核查，立昂微电及其关联企业历史沿革中涉及浙大海纳、宁波海纳的有关国有股权变动，存在当时未进行资产评估、未办理评估备案、以及未经过合理的股东大会（或董事会）决策等程序瑕疵问题，但未最终造成浙大海纳、宁波海纳投资的直接损失；因此，浙江省国资委认为，立昂微电及其关联企业在浙大海纳与宁波海纳的投资和退出过程中存在的瑕疵没有造成国有资产的损失。2020年6月23日，浙江省人民政府办公厅出具了《浙江省人民政府确认函》，浙江省人民政府同意浙江省国资委的确认意见。

（十一）经营业绩下滑的风险

2019年，公司销售规模及综合毛利率基本保持稳定，实现的营业收入及营业毛利分别为119,168.60万元和44,466.75万元，较去年分别小幅调整2.53%和3.51%。公司扣除非经常性损益前后归属于母公司股东孰低的净利润为8,579.38万元，同比下降44.77%，主要是由于研发费用、财务费用与资产减值损失、信用减值损失同比大幅增加所致。如果未来营业毛利无法实现增加或费用损失等其他损益科目的金额无法大幅下降，公司经营业绩存在下滑的风险。

十二、保荐机构对于发行人持续盈利能力的核查意见

经核查，保荐机构认为：报告期内发行人财务状况和盈利能力良好，发行人的经营模式、产品或服务的品种结构未发生重大变化；发行人的行业地位及所处行业的经营环境未发生重大不利变化；发行人最近一年的营业收入或净利润对关联方或者有重大不确定性的客户不存在重大依赖；发行人最近一年的净利润不是主要来自财务报表范围以外的投资收益；发行人在用的商标、专利、专有技术等重要资产或者技术的取得或者使用不存在重大不利变化。综上，发行人具备持续盈利能力，但投资者应关注本招股意向书“第四节风险因素”中披露的相关风险因素的影响。

十三、2019年经营业绩变化情况

2019年，公司扣除非经常性损益前后归属于母公司股东孰低的净利润为8,579.38万元，同比下降44.77%，公司经营业绩下降的具体原因如下：

（一）公司的核心业务、经营环境、主要指标未发生重大不利变化

1、公司核心业务未发生重大不利变化

公司自设立以来，核心业务为半导体分立器件芯片的研发、生产和销售，主要产品包括肖特基二极管芯片、MOSFET芯片等。自2015年收购同一实际控制人控制下的公司浙江金瑞泓后，公司的核心业务延伸至上游的半导体硅片的研发、生产和销售，半导体硅片主要产品包括硅研磨片、硅抛光片、硅外延片等。2017年至2019年，公司的营业务收入分别为93,201.96万元、122,266.70万元和119,168.60万元，主营业务收入的增长率分别为31.18%和-2.53%，公司的核心业务未发生重大不利变化。

2、公司经营环境未发生重大不利变化

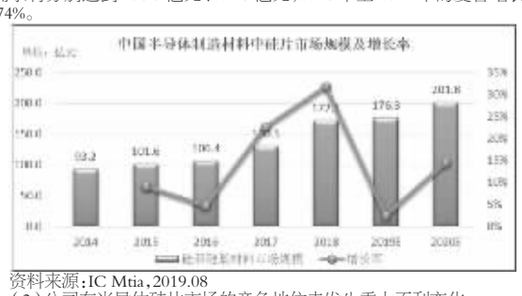
（1）半导体硅片市场经营环境未发生重大不利变化

近年来，全球半导体硅片市场存在一定的波动。2009年，受经济危机的影响，全球半导体硅片市场规模急剧下滑，出货量下降；2010至2013年，半导体硅片市场随全球经济逐渐复苏而反弹，同时12英寸大尺寸半导体硅片技术逐渐普及；2014年至今，受益于通信、计算机、汽车产业、消费电子、光伏产业、智能电网、医疗电子等应用领域需求带动以及人工智能、物联网等新兴产业的崛起，全球半导体硅片出货量呈现上升趋势。

资料来源：SEMI，2020.02

根据SEMI统计，全球半导体硅片市场规模在2018年大幅增长至113.8亿美元后出现小幅回调，2019年为111.5亿美元，预期2020年将达到114.6亿美元。

自2014年以来，我国半导体硅片市场规模呈稳定上升趋势。根据IC Mtia统计，2018年中国半导体硅片市场需求为172.1亿元，预计2019、2020年的市场需求将分别达到176.3亿元、201.8亿元，2014年至2019年的复合增长率为13.74%。



资料来源：IC Mtia，2019.08

（2）公司在半导体硅片市场的竞争地位未发生重大不利变化

从国内半导体硅片市场来看，由于我国从20世纪90年代才逐步开始加大对半导体产业的投入力度，同国外发达国家相比整体起步较晚，长期以来，我国半导体硅片供应商主要生产6英寸及以下半导体硅片，以满足国内需求，市场格局较为稳定。而近年来，大尺寸半导体硅片国产化成为我国半导体领域的重要战略目标和努力方向，国内企业在8英寸半导体硅片生产方面与国际先进水平的差距已得到较大程度的缩小，但12英寸半导体硅片由于核心工艺技术难度更高，尚无法实现大规模量产。

根据IC Mtia统计，目前国内从事硅材料业务的公司主要包括浙江金瑞泓、有研半导体、中环股份、南京国盛、上海新昇、上海新傲、河北普兴、昆山中辰等十余家。截至2018年底，浙江金瑞泓具备月产12万片8英寸硅抛光片的生产能力，衢州金瑞泓正在建设的集成电路用8英寸硅片项目将增加月产能10万片；中环股份已实现月产30万片8英寸硅抛光片的生产能力；有研半导体具备月产10万片8英寸硅片的生产能力，在建8英寸硅片生产线月产能将达到15万片。在12英寸硅片开发与产业化方面，上海新昇12英寸硅片生产线已达到月产能10万片；发行人负责12英寸硅片产业化项目的子公司金瑞泓微电子正在建设年产180万片集成电路用12英寸硅片项目；重庆超硅已建成12英寸硅抛光片中试线。发行人、上海新昇等国内半导体硅片企业正在进行国产12英寸半导体硅片的产业化工作，有望在未来实现12英寸半导体硅片的大规模量产。

发行人控股子公司浙江金瑞泓长期致力于技术含量高、附加值高的半导体硅片的研发与生产，具有硅单晶锭、硅研磨片、硅抛光片、硅外延片的完整工艺和生产能力。2004年，公司6英寸半导体硅抛光片和硅外延片开始批量生产并销售，成为国内较早进行6英寸硅片量产的企业；2009年，公司8英寸半导体硅外延片开始批量生产并销售，实现我国8英寸硅片正片供应的突破；通过承担十一五国家02专项，公司具备了全系列8英寸硅单晶锭、硅抛光片和硅外延片大批量生产制造的能力，并开发了12英寸单晶生长核心技术，以及硅片倒角、磨片、抛光、外延等一系列关键技术，上述8英寸半导体硅片的大规模产业化和12英寸半导体硅片相关技术已于2017年5月通过国家02专项正式验收，标志着浙江金瑞泓已走在我国大尺寸半导体硅片生产工艺研发的前列。

浙江金瑞泓所生产的半导体硅片产品广泛应用于集成电路、半导体分立器件等领域，浙江金瑞泓已经成为ONSEMI、AOS、日本东芝公司、台湾汉磊等国际知名跨国公司以及中芯国际、华虹宏力、华润微电子等国内知名企业的重要供应商。

根据中国半导体行业协会的统计，报告期内浙江金瑞泓在2015年至2017年中国半导体材料十强企业评选中均位列第一名。作为国内主要的半导体硅片生产厂商之一，公司在国内半导体硅片行业具有较高的行业地位及较强的行业影响力，具备一定的竞争优势。

（3）半导体分立器件市场经营环境未发生重大不利变化

近年来，全球分立器件市场销售规模基本保持稳定。根据WSTS统计，2018年全球半导体分立器件销售额达241.02亿美元，同比增长11.3%；2019年为238.81亿美元，同比下降0.92%。根据WSTS预测，全球半导体分立器件市场规模将在2020年至2021年基本保持稳定。

（下转A47版）

杭州立昂微电子股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告

（上接A45版）

（三）只有符合联席主承销商确定条件的投资者及其管理的配售对象才能够参与初步询价。联席主承销商提醒投资者在参与询价前应自行核查是否符合本公告“二、（一）参与网下询价的投资者资格条件”的相关要求。同时，投资者应于2020年8月26日（T-4日）中午12:00前，按照本公告“二、（二）网下投资者资格核查文件的提交”的相关要求及时提交网下投资者资格核查材料。

（四）本次初步询价采取价格与数量同时申报的方式进行。网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数，且只能有一个报价，其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价，同一机构管理的不同配售对象的报价应该相同。网下投资者可以为其管理的每一配售对象填报同一个拟申购价格，该拟申购价格对应一个拟申购数量。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后，应当一次性提交。网下投资者可以多次提交报价记录，但以最后一次提交的全部报价记录为准。

网下投资者管理的每个配售对象参与本次网下发行的最低拟申购数量为500万股，拟申购数量最小变动单位设定为10万股，即网下投资者管理的每个配售对象的拟申购数量超过500万股的部分必须是10万股的整数倍，且不超过1,000万股。

（五）网下投资者申购报价存在以下情形的，将被视为无效：投资者未能在2020年8月26日（T-4日）中午12:00前在中国证券业协会完成网下投资者注册的；配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等申报信息与备案信息不一致的；私募投资基金未能完成管理人登记和基金备案的；配售对象拟申购数量超过1,000万股以上的部分为无效申报；单个配售对象拟申购数量低于500万股、或者拟申购数量不符合10万股的整数倍要求的申购报价，该配售对象的申报无效；未按本公告要求提交投资者资格核查文件、或者经核查不符合本公告网下投资者资格条件的；被中国证券业协会列入的首次公开发行股票配售对象黑名单及限制名单的配售对象；经发行人和联席主承销商认定的其他情形。

（六）上海金茂凯德律师事务所将对本次发行的初步询价过程进行见证，并出具专项法律意见书。

四、定价及有效报价的确定

初步询价结束后，发行人和联席主承销商根据剔除无效报价后的询价结果，对所有参与初步询价的配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间（以上交所网下申购平台显示的申报时间及申报编号为准）由后到前的顺序排序，剔除拟申购总量中报价最高部分的数量，剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

在剔除最高部分报价后，发行人和联席主承销商考虑剩余报价及拟申购数量、所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定发行价格、有效报价投资者数量及有效拟申购数量。发行人和联席主承销商按照上述原则确定的有效报价网下投资者家数不少于10家。有效报价是指，在剔除最高报价部分后的剩余报价中申购价格不低于发行价格，且符合发行人和联席主承销商事先确定且公告的其他条件的报价。

在初步询价期间提交有效报价的网下投资者方可且必须参与网下申购。发行价格及其确定过程，以及可参与网下申购的配售对象及其有效拟申购数量信息将在《发行公告》中披露。

五、网下网上申购

（一）网下申购

本次发行的网下申购时间为2020年9月1日（T日）的9:30-15:00。《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购，在参与网下申购时，其申购价格为确定的发行价格，申购数量须为其初步询价中的有效拟申购数量。

网下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价配售对象在上交所网下申购电子平台录入申购记录后，应当一次性提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。

网下投资者在2020年9月1日（T日）参与网下申购时，无需为其管理的配售对象缴付申购资金，获得初步配售后在2020年9月3日（T+2日）缴纳认购款。

（二）网上申购

本次发行的网上申购时间为2020年9月1日（T日）的9:30-11:30、13:00-15:00，网上发行通过上交所交易系统进行。根据投资者2020年8月28日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有上海市场非限售A股和非限售存托凭证市值确定其网上可申购额度，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但申购上限不得超过按其持有上海市场非限售A股份市值计算的可申购额度上限，且不得超过本次网上初始发行数量的千分之一，即不超过12,000股。投资者持有市值的计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的相关规定，投资者可以通过其指定交易的证券公司查询其持有市值或可申购额度。

网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。网上投资者在2020年9月1日（T日）参与网上申购时，无需缴